

大電流対応厚銅基板

Heavy Copper PWB

特長 Features / 用途 Application

●大電流ユニットに対応

Copper Thickness: 175 μ m~210 μ m

※内層210 μ m (開発中)



サーボモータ



インバーター



大電流変電設備



大型エンジン発電機

●銅厚：175 μ m~210 μ m

Correspondence to Large Current unit



エンジンECU



無線給電用のコイル

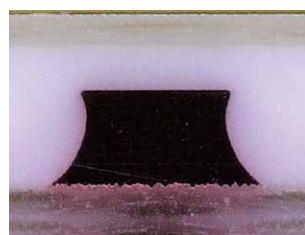
基板仕様 PWB specification

基板種類	内層導体厚	層構成	板厚	最小導体幅	最小導体間隔	層間厚
厚銅貫通	量産中 175 μ m	~6層	~3.0mm	400 μ m	400 μ m	300~350 μ m
	R&D 210 μ m	~6層	~3.0mm	450 μ m	450 μ m	300~350 μ m
基板種類	内層導体厚	層構成	板厚	LVH径	めっき厚	層間厚
厚銅ビルド	R&D 105 μ m	~6層	~3.0mm	150 μ m	60 μ m	110 μ m



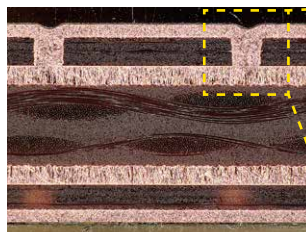
量産中 充電設備/6層貫通 内層175 μ m

広州工場にて6層貫通基板 (内層175 μ m) の量産実績あり



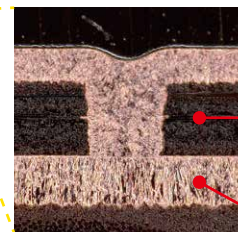
R&D 内層210 μ m以上

絶縁層形成に樹脂シートを使用することで、絶縁信頼性向上、薄板化、軽量化が可能。



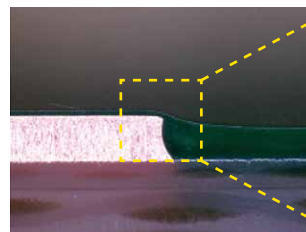
R&D 厚銅ビルド基板 内層105 μ m

厚銅回路の高密度化。
制御系と電源系の基板一体化が可能。



絶縁層：
110 μ m

内層導体厚
105 μ m



R&D 外層超厚銅 (210 μ m以上) 対応

外層厚銅 (210 μ m) 対応したSR塗布工法により大電流化が可能。

